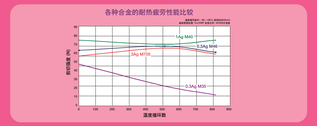
M40 下一代具有与以往产品同等性能的低银焊膏

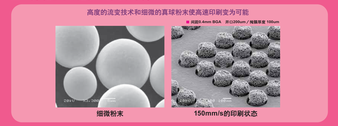
特 点

- 即使在与M705同等的条件下进行实装，也可实现“低价化”和“高品质”。…LS-720系列
- 高速印刷&短时间回流，提高生产效率约30%…SP系列

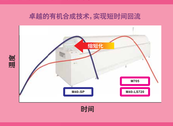
□ 与M705同等或以上，低银也能确保高品质



□ 可高速印刷的SP系列焊膏



□ 可以短时间回流的SP系列焊膏



□ SP系列，可缩短生产周期约30%

□ Ni/Pd电镀部品的良好浸润性

SMIC
Senju Metal Industry Co., Ltd.

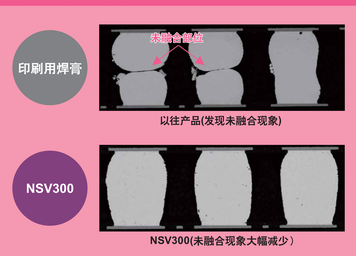
3D实装POP用转印焊膏 M705-NSV300 NSV300

特 点

- 具有良好的转印性能，大幅度减少Ball-Ball实装的未融合现象
- 对应POP、TMV Pakage，实现良好的焊接性能

□ 可有效地转印定量的焊锡

□ 使用了NSV300的POP实装



SMARTPHONE

理想之创新，连接全世界

特 点

- 在短时间内呈现稳定的润湿性，能提高自动控制装置的生产效率。
- 抑制焊料和助焊剂飞散。

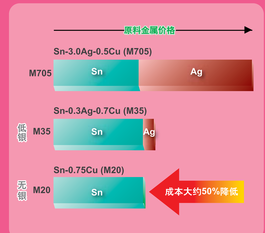
对于预测焊锡量不足的实装，0402尺寸也产品化

- 可与SMD同时自动搭载的缠绕式规格
- 与焊膏同时熔化，无需追加焊锡
- 适当供给焊锡量，确保连接可靠性

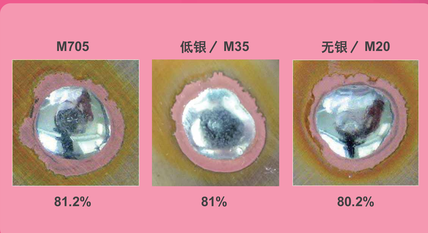
特 点

□ 焊料润湿速度比较(椭圆形状比较)

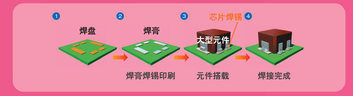
□ 原料金属价格减半



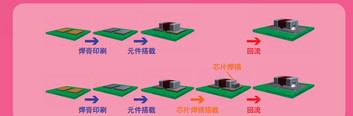
□ 虽然是低银或无银，但具有良好的润湿性



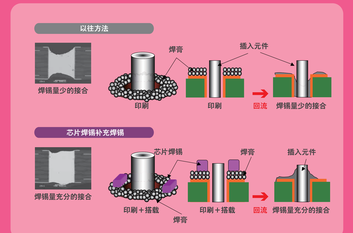
□ 增加大型元件的接合强度



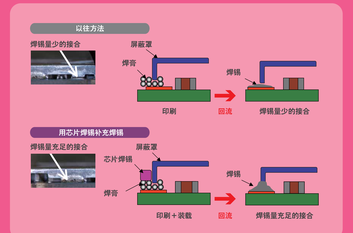
□ 自动搭载芯片焊锡，同时熔化



□ 回流增加插入组件的接合强度



□ 增加屏蔽罩的接合强度



NEO 成本减半 低银 M35/无银M20

Smart Connection

对于预测焊锡量不足的焊盘面，采用“芯片焊锡” 芯片焊锡